

Serveurs

LENOVO THINKSERVER TD230

Détails de la notation :

C-	NOTE RSE	>
D-	NOTE CYCLE DE VIE	>
E-	NOTE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE	>

Code EAN :

[VOIR LA FICHE CONSTRUCTEUR >](#)

[DÉCOUVRIR NOTRE MÉTHODOLOGIE >](#)

Gamme de prix

1000 – 2000 €



Le serveur ThinkServer TD230 de LENOVO au format Tour propose une capacité de stockage de 2000 Go.

Il est labellisé Energy Star .



ENERGY STAR

MATURITÉ RSE



C-

CYCLE DE VIE



D-

3 ans

De garantie

5 ans

De disponibilité des pièces

LES PLUS

- Possibilité d'extension ou d'échange

LES MOINS

- Ne communique aucune information

de la mémoire

sur le respect de REACH

- Possibilité d'extension ou d'échange

de la capacité de stockage

- Est garanti 3 années
- Pièces de rechange disponibles

durant 5 années

EXTRACTION DES MATIÈRES PREMIÈRES

Masse de la RAM (Go) **2**

Masse de la Mémoire Flash (Go) **Non-communicé**

Masse de la carte mère **Non-communicé**

Masse du microprocesseur + masse de la carte graphique ou la surface de silicium dans le microprocesseur la carte graphique **Non-communicé**

FABRICATION

Utilisation de CFCs, HCFCs, 1.1.1 trichloro-ethane ou carbon-tetrachloride pour la production du produit final ou des modules le composant au sein du produit **Non-communicé**

DISTRIBUTION

Monomatière dans l'emballage **Non-communicé**

Emballage sans PVC **Non-communicé**

UTILISATION

Emission de COV (mg/h) **Non-communicé**

Limitation des champs électromagnétiques créés par le produit **Non-communicé**

DURÉE DE VIE EN PARC

Durée de garantie (année) **3**

Disponibilité des pièces dans le temps (année) **5**

FIN DE VIE

Exclu des substances au-delà des exigences réglementaires **Non-communicé**

Identification des plastiques **Non-communicé**

Contient des substances REACH **Oui**

Contient du PVC dans les parties extérieures du produit	Non-communicué
Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les plastiques	Non-communicué
Contient du mercure dans les sources de lumières dans l'électronique	Non-communicué
Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les circuits imprimés et dans l'électronique	Non-communicué
Contient du PVC dans l'électronique	Non-communicué
Présence de revêtement de surface pour les parties plastiques du boîtier/capots	Non-communicué
Communication du pourcentage de recyclabilité, selon le calcul IEC/TR 62635:2012	Non
Extension ou échange de la mémoire possible	Oui
Possibilité d'échange ou d'extension de la capacité de stockage	Oui
Parties et étiquettes facilement séparables	Non-communicué
Pièces plastiques monomatériaux ou facilement séparables	Non-communicué
Pièces plastiques sans incrustation métallique ou faciles à extraire avec les outils couramment disponibles	Non-communicué

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



Dispositif d'économie d'énergie	Non
---------------------------------	------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Taille du rack (U)	Tour
Type de disque dur	SATA
Taille du disque dur	2000
Type de RAM	DDR3
Type de processeur	Intel Xeon séries 5500 et 5600
Cadence du processeur (GHz)	2
Carte DRAC	Non-communicé
Carte contrôleur	Non-communicé
Carte Réseau	Non-communicé
Dissipation calorifique (kj/h)	Non-communicé
Dimensions HxLxP (mm)	Non-communicé